

Descripción

- PC Box para montaje en fondo de panel
- Basado µP Intel Celeron M o Intel Core 2 Duo
- Alimentación 110 - 220 Vac ó 18 - 36 Vdc



Configuraciones

Item	H1	H3	H4	Característica
CPU	•	•	•	Intel Celeron M430, 1.73 GHz, 533 MHz, front side bus, cache de 1 MB, zócalo 478 µFC-PGA
	•	•	•	Intel Celeron M575, 2 GHz, 667 MHz, front side bus, cache de 1 MB, zócalo 478 µFC-PGA
	•	•	•	Intel Core 2 Duo T5750, 2 GHz, 667 MHz, front side bus, cache de 2 MB, zócalo 478 µFC-PGA
	•	•	•	Intel Core 2 Duo T7250, 2 GHz, 800 MHz, front side bus, cache de 2 MB, zócalo 478 µFC-PGA
	•	•	•	Intel Core 2 Duo T7500, 2.2 GHz, 800 MHz, front side bus, cache de 4 MB, zócalo 478 µFC-PGA
Memoria RAM	•	•	•	512 MB, 1 SODIMM (módulo DDR2 PC5300)
	•	•	•	1 GB, 1 SODIMM (módulo DDR2 PC5300)
	•	•	•	2 GB, 1 SODIMM (módulo DDR2 PC5300)
	•	•	•	4 GB, 2 SODIMM (módulo DDR2 PC5300), 2 GB cada uno
Tensión de Alimentación	•	•	•	Autorango 110 ~ 220 Vac, 140 W
	•	•	•	Autorango 18 ~ 36 Vdc, 140 W
Ranuras de Expansión	•			Sin slots PCI
		•		2xPCI half size (on riser card)
		•		1xPCI, 1xPCI-Express x4, formato half size (on riser card)
		•		3xPCI, 1xPCI-Express x4, formato half size (on riser card)
		•		2xPCI, 1xPCI-Express formato x1, 1xPCI-Express formato x4, half size (on riser card)
Kit de fijación	•	•	•	Con el Kit, dimensiones máximas para PCI y PCI-E add-on cards: 185x122 mm.
	•	•	•	Sin el Kit, dimensiones máximas para PCI y PCI-E add-on cards: 185x107 mm.

Configuraciones básicas

Item	H1	H3	H4	Característica
PB650	•			Intel Celeron M430, 1.73 GHz, RAM 512 MB, Tensión 220 Vac, sin slots PCI
		•		Intel Celeron M430, 1.73 GHz, RAM 512 MB, Tensión 220 Vac, 2xPCI
		•	•	Intel Celeron M430, 1.73 GHz, RAM 512 MB, Tensión 220 Vac, 3xPCI, 1xPCIe x4

Serie PB 650

Opciones

Item	H1	H3	H4	Característica
Disco Duro	•	•	•	Kit de instalación HDD/SSD 2.5" SATA (No incluidos los HDD/SSD)
	•	•	•	HDD 80 GB, 2.5", SATA 2 3Gb/s, 5400 rpm, buffer de 8 MB
	•	•	•	SSD 2.5", SATA 2.3 Gb/s (disco de estado sólido)
		•	•	Kit HDD 160 GB, 3.5" SATA, 2.3 Gb/s, 7200 rpm, buffer de 8 MB
FDD/CD/DVD (Acceso trasero)		•	•	Kit FDD 3.5", 1.44 MB Slim, altura: 0.5", frontal negro
		•	•	Kit DVD-RW SATA 8x Slim, altura: 0.5", frontal negro
		•	•	Kit FDD 3.5", 1.44 MB Slim + DVD-RW SATA 8x Slim, altura: 1", frontal negro
Puertos de comunicación	•	•	•	Puerto serie adicional RS-232/422/485, conector Macho DB15 *
	•	•	•	Puerto serie adicional RS-232/422/485, RS=422/485 opto-acoplado, conector Macho DB15 *
	•	•	•	Puerto paralelo SPP-EPP-ECP, bidireccional, conector Macho DB25 *

* Los puertos adicionales serie y el puerto paralelo se pueden instalar uno u otro alternativamente

Especificaciones Técnicas

Característica	Valor
Carcasa	Montaje en placa
Protección frontal	IP=65
Placa Base	"ALL-In-One", ASEM 1021, con watchdog timer, sistema de hardware para diagnóstico de temperatura y de tensión de placa
Chipset	Intel 82GME965, FSB 533/800 MHz
Graphic Core	Intel GMA X3100
Controlador de vídeo	Integrado en placa, Interface estándar analógico VGA (puerto externo), Interface digital LVDS para TFT LCD (zócalo interno) y DVI (externo)
Memoria de vídeo	Máximo 256 MB (seleccionable en el setup del sistema)
Zócalos de memoria RAM	2xSODIMM, 200 pin
Memoria RAM	DDR2 tipo PC5300, perfil bajo
Memoria de sistema	Mínimo: 512 MB, máximo: 4 GB
Interfaces de almacenamiento	1xFDD, 1xATA/100 (maestro, esclavo), 2xSATA/150
Ranuras Compact Flash	1x Compact Flash tipo II (acceso trasero)
Interfaces de acceso frontal	2xUSB (2.0), conector estándar A
Interfaces de acceso trasero	2xPS/2 (K/M), 1xEthernet 10/100/1000 Mbit (RJ45), 1xEthernet 10/100 Mbit (RJ45), 4xUSB (2x2.0) conector estándar A 1xVGA analógica (conector Hembra DB15), 1xDVI (conector Hembra 24 polos), 2xRS-232 (conector Macho DB9)
Temperatura ambiente	De funcionamiento: con HDD: 0 ~ +45 °C, sin HDD: 0 ~ +50 °C. De almacenaje: -20 ~ +60 °C
Humedad ambiente	80 % (sin condensación)

Croquis de dimensiones pantalla PB 650

